

平成 25 年 9 月 11 日

公募の通知 [1]

部品内蔵基板設計データフォーマット FUJIKO の改良開発公募要領

[1] 公募期間 (期間厳守)

平成 25 年 9 月 11 日～平成 25 年 9 月 24 日 (※最終日は 17 時まで)

[2] 開発内容

JPCA 規格 JPCA-EB02 (2013) に準拠して開発された部品内蔵基板設計データフォーマット FUJIKO の改良開発

(1) 開発の概要

FUJIKO Ver1.0 で開発された構造情報やネット情報に合わせて福岡大学が定義する、基板の構造に関する基板定義データ及び内蔵する電子部品形状や特性に関する部品定義データについて、属性等の詳細設計および、当該データを FUJIKO に反映するための機能追加を実施するもの。

(2) 具体的内容

部品内蔵基板の製品設計、基板製造、部品実装、検査の各工程で有効となる属性情報を設計する。また、CAD 設計用の属性、実装機用の属性、検査機用の追加属性を設計する。

上記で設計した属性情報を FUJIKO にて取り扱えるよう、FUJIKO の機能追加を行う。

[3] 公募提出物等

(1) 提出物：① 会社概要、② 見積書、③ 開発内容に対する企画書

①、②は紙での提出。③は CD-R 又は DVD-R でのデータ提出。

様式はいずれも任意。ただし企画書には、基板定義データおよび部品定義データに付加すべき属性情報の提案、および当該データを FUJIKO に反映する際の追加機能の仕様について記述する事。

(2) 提出先：福岡大学半導体実装研究所

[4] 審査

専門家からなる審査委員会において審査の上、決定。

[5] 審査結果決定、発注先通知

平成 25 年 9 月 30 日

[6] 開発期間

平成 25 年 10 月 1 日～平成 25 年 12 月 27 日

[7] 納入締切・納入先

平成 26 年 1 月 4 日

納入先：福岡大学半導体実装研究所

[8] 検証（予定）

平成 26 年 1 月 5 日～平成 26 年 1 月 31 日

[9] 検収（予定）

平成 26 年 2 月 1 日

[1 0] 本件に関する問合せ先、見積等資料提出先、提出方法

郵送による提出のみ

福岡大学半導体実装研究所 加藤義尚宛

〒819-1122 福岡県糸島市東 1963-4 三次元半導体研究センター内

TEL:092-332-9144 E-Mail:ykatoh@fukuoka-u.ac.jp

以上